/公司代码:603920　　公司简称:世运电路

广东世运电路科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	世运电路	603920	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹嘉亮	刘隽
电话	0750-8911768	0750-8911371
办公地址	广东省鹤山市共和镇世运路8号	广东省鹤山市共和镇世运路8号
电子信箱	yinjialiang@olympicpcb.com	jason.liu@olympicpcb.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,881,072,466.48	8,988,996,135.42	-1.20
归属于上市公司股东的净资产	6,444,805,740.60	6,471,158,063.35	-0.41
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,578,768,934.58	2,395,654,508.53	7.64
利润总额	431,827,273.01	343,541,280.70	25.70
归属于上市公司股东的净利润	384,134,793.67	302,735,169.28	26.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,547,034.64	298,245,792.66	19.55
经营活动产生的现金流量净额	428,266,324.20	329,614,300.45	29.93
加权平均净资产收益率(%)	5.69	6.89	减少1.20个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.51	3.92
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.48	10.42

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	104,612
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东顺德控股集团有限公司	国有法人	23.67	170,546,596	0	无	0
新豪国际集团有限公司	境外法人	20.12	144,990,107	0	无	0
广东顺德高新创业投资管理有限公司－广东顺德科创璜顺股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.01	21,697,368	0	无	0
深圳市沃泽科技开发有限公司	境内非国有法人	1.02	7,316,323	0	无	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.55	3,995,519	0	无	0
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50	3,576,892	0	无	0
鹤山市联智投资有限公司	境内非国有法人	0.40	2,866,288	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.36	2,584,482	0	无	0
招商银行股份有限公司－国泰研究优势混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36	2,569,023		无	0
中国工商银行股份有限公司－华夏核心制造混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35	2,501,730		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新豪国际集团有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司、鹤山市联智投资有限公司为关联方,除此之外,公司未知其他股东(无限售条件股东)之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2025-063

广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议(以下简称"会议")通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出,于2025年8月26日在公司三楼一号会议室以现场表决的方式召开,并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席林玉媛主持,会议应参加监事3人,实际参加3人,公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于《世运电路2025年半年度报告》及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路2025年半年度报告》及其摘要,《世运电路2025年半年度报告摘要》将同步在公司选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上披露。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

(二)审议并通过《关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的议案》

根据公司发展战略和实际情况,公司拟将原募投项目"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"尚未投入的部分募集资金52,000.00万元变更投向至新项目"泰国高峰绿色工业园新建年产120万平方米高端、高精密度印刷电路板建设项目(一期)";同时,基于原募投项目"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"目前实际建设进度,剩余尚未投入的募集资金合计49,515.35万元将继续用于原募投项目的投资建设。

同时,公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度,"鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)"将达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2027年6月";"广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目"将达到预定可使用状态日期由"2025年12月"延长至"2026年12月"。新项目达到预定可使用状态日期为2026年12月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于变更部分募投项目及部分募投项目延期的公告》。

监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目及募集资金投资项目延期事项是公司结合实际情况和自身发展战略,经慎重研究作出的决策,符合公司实际经营需要,不存在损害股东利益的情形。该事项的决策和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

该议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

(三)审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司编制了《世运电路关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《世运电路关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避表决。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2025年8月27日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2025-065

广东世运电路科技股份有限公司关于拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")或控股子公司拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目(以下简称"芯创智载"项目)
- 投资金额:人民币15.00亿元
- 审批情况:本次投资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议批准。本次拟投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。
- 风险提示:本次投资项目是公司基于未来发展战略,经筹划论证所做出的谨慎决定,项目投产运营后可能面临受宏观经济、行业环境、市场变化、经营管理等因素影响,可能造成投资项目不达预期效益的风险。本次投资项目的投资金额、建设周期等为预估数,实际建设过程中存在一定的不确定性,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。项目预计在2025年下半年动工建设,2026年中开始投产,公司对2025年经营业绩不会造成重大影响。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

随着近年人工智能及新能源汽车的高速发展,PCB作为电子产业的一种核心基础组件,对PCB供应商的生产工艺以及供应链联合创新能力提出了更高的要求,包括具有高密度及多层设计、高性能材料、精细制造工艺、优质的信号传输及散热等特性。公司于2022年获广东省发展和改革委员会批准成立"新一代电动汽车高端芯片互连载板创新平台",依托该平台着力发展"芯片内嵌式PCB封装技术",即采用嵌埋工艺将功率芯片直接嵌入到PCB板内,通过创新的制程工艺实现器件与PCB的一体化,优化芯片与电路板的信号传输路径与散热性能,提高系统功效和可靠性,在新能源汽车、数据中心、高功率通信设备、人形机器人、储能、航空航天等领域具有广阔的应用前景。目前该项目已经取得显著成果,芯片内嵌式PCB产品已经通过一系列静态、动态测试达成性能设计和信赖性要求,并陆续获得终端主机厂客户项目定点。

为推进芯片内嵌式PCB产品规模化生产以及进一步提升公司高阶HDI产品的产能,公司计划在鹤山总部周边地块建设"芯创智载"项目,项目预计总投资约15.00亿元人民币,主要产品为芯片内嵌式PCB产品和高阶HDI电路板产品,设计产能为66万平方米/年。

(二)审议情况

公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟投资建设"芯创智载"新一代PCB智造基地项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。本次拟投资项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

本次对外投资事项不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、投资项目基本情况

(一)项目名称:"芯创智载"新一代PCB智造基地项目

(二)项目实施主体:公司或控股子公司

(三)项目实施地点:鹤山市共和镇铁岗工业区

(四)项目投资概算:项目总投资额为人民币15.00亿元,具体将根据实际进展分阶段投入,最终以项目建设实际投资开支为准

(五)项目建设内容:本项目总投资额为15.00亿元,其中建筑工程费4.63亿元,设备购置及安装费9.62亿元,铺底流动资金0.6亿元。项目通过引进国内外先进的印刷电路板生产设备及配套设施,招聘高素质的技术、管理和生产人员,旨在提升公司高端电路板的量产能力,满足下游客户对PCB不断提升的工艺要求,以及增强公司的核心竞争力。

(六)项目产品类型及产能:芯片内嵌式PCB产品18万平方米/年,高阶HDI电路板产品48万平方米/年。

(七)项目建设周期:18个月,计划于2025年下半年动工建设,2026年中开始投产。

(八)资金来源:自有或自筹资金

(九)项目进展及审批,备案情况:项目尚处于筹备阶段,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作。

三、本次投资的背景、必要性及可行性

(一)本次投资的背景和必要性

根据Prismark预计,2025年HDI和18层以上多层板将分别增长12.9%和41.7%,从中长期来看,18层以上高多层板和HDI受到人工智能相关产业的驱动,2024年-2029年复合增长率将分别达15.7%和6.4%,高于PCB行业整体的5.2%平均增速。其中,芯片内嵌式PCB产品是PCB未来的发展方向之一。芯片内嵌带来三大核心优势:(1)消除键合线,减小机械应力失效,显著提升芯片互连技术的可靠性;(2)通过消除键合线并采用超短连接路径,电感可降至1nH以下,进一步会降低开关损耗和电压过冲,大幅改善电气性能;(3)通过内嵌的方式,不仅减少了封装体占用的空间、降低了封装成本,还一定程度提升了电气性能和散热效果。通过功率芯片PCB封装化实现模组高能耗比、高密度轻量化和高可靠性。

人工智能、新能源汽车等重点下游领域增速较快,带动高端PCB需求和价值增长,首先,从市场需求角度,公司HDI业务近两年需求增长强劲,特别是人工智能、汽车电子、医疗电子等领域订单显著增加,而当前公司现有的HDI产能不足,制约了公司在这些高增长领域的业务拓展。其次,从公司战略布局来看,推进芯片内嵌式PCB产品规模化生产以及进一步提升公司高阶HDI产品的产能有助于公司优化产品结构,提升在高端 PCB 领域的竞争力,符合公司向高附加值产品领域转型的长期战略目标。通过扩大高端产品产能,公司能够进一步提升规模效应,降低单位生产成本,提高产品的市场竞争力,增强公司的盈利能力与抗风险能力。综上,公司计划因应市场需求变化,放缓公司定增募投项目的建设进度,将资源优先集中推动建设"芯创智载"项目。

(二)本次投资的可行性

凭借多年在PCB研发、生产经验,公司拥有PCB制造领域多项核心技术,并高效地转化为产品竞争力的提升。公司目前已经掌握本项目的核心技术"芯片内嵌式PCB封装技术",相关产品已经通过一系列静态、动态测试达成性能设计和信赖性要求,并获得部分主流汽车终端主机厂和OEM的认可。

此外,经过多年发展,公司凭借先进的技术、高质量的产品和专业的服务,已与国内外众多知名品牌商建立了长期稳定的合作关系,积累大量优质稳定的客户资源,广泛分布于人工智能、新能源汽车、人形机器人、低空飞行器、AI智能眼镜等新兴领域。

四、本次投资对上市公司的影响

公司拟投资建设"芯创智载"项目,旨在提升公司高端电路板的量产能力,满足下游客户对PCB不断提升的工艺要求,以及增强公司的核心竞争力。芯片内嵌式PCB产品目前主要应用在新能源汽车动力域,通过更高的集成度和动率密度,显著提升了电气性能,包括降低系统杂感及开关损耗,大幅提升开关速度,从而实现提升续航里程的效果。目前芯片内嵌式PCB产品已获得部分主流汽车终端主机厂和OEM的认可,产品需求市场日趋扩大。本项目具备良好的预期经济效益,建成后将为公司增加新的利润增长点,提升企业品牌影响力,与公司的长远规划和高质量发展战略要求相契合。该项目的建设不会损害上市公司及股东的利益,特别是中小股东的利益。

本次对外投资的资金全部来源于公司或控股子公司自有或自筹资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。同时,本次拟新设的控股子公司将纳入公司合并报表,不存在损害公司及其他股东的合法利益的情形。

五、对外投资的风险分析

(一)市场竞争风险

随着国内PCB同业在新能源汽车、数据中心/服务器、通信设备PCB等领域的布局,后续市场竞争可能存在愈发激烈的风险,进而影响行业整体的盈利能力。虽然目前行业领先企业具有较为明显的综合竞争优势,在客户、规模、研发、技术、质量、成本控制等多个方面均处于优势地位。但由于国内从事PCB生产的企业较多,且部分企业成长较快,竞争力日趋增强。随着市场的扩大,竞争对手也将加大对产品研究开发和市场开拓力度,导致竞争加剧,项目可能面临客户及订单数量不及预期的风险。公司将加大研发投入,提升技术能力,开发高附加值的新产品,调整产品结构,提升高端产品占比,积极开拓新的订单稳定的客户,以此提高公司抗风险能力。

(二)项目建设、产能爬坡不达预期风险

本项目在实施过程中,可能存在工程建设进度不及预期、设备采购及安装调试延期、设备价格和原材料价格波动等问题,导致项目建设周期延长、实际投资额超出预算,实际产能爬坡速度和达产时间与预期存在差异。公司将成立项目管理团队,制定详细的项目实施计划和应急预案,加强与供应商及承建商等合作伙伴的沟通协调,产能控制项目进度和成本管理,确保项目按计划推进。

(三)项目管理风险

高端PCB产品技术含量高,若公司在技术研发、工艺创新方面未能持续投入或未能准确把握行业技术发展趋势,可能导致新增产能的技术水平未能跟上市场需求变化,产品竞争力下降。新产品在量产过程中可能面临良率不稳定、产能利用率不高等问题,影响项目盈利能力。公司将继续强化研发优势,保证产品符合客户需求、适应行业发展趋势,并将通过科学的管理手段继续提高产品质量的稳定性,以良好的质量推动市场份额的提升。

(四)项目资金风险

本项目总投资约15亿元人民币,资金来源为自有资金或自筹资金,若未来公司经营活动现金流不及预期或外部融资环境发生不利变化,可能面临一定的资金筹措压力。截至2025年6月30日,公司营业收入25.79亿元,货币资金14.93亿元,交易性金融资产28.26亿元,总资产88.81亿元,资产负债率25.20%。公司资信情况良好,银行授信额度充足,没有对外担保。公司将根据项目建设进度和资金需求,与供应商充分协商更友好的付款方式,根据需要科学规划融资方案,优化资本结构,合理控制融资成本和财务风险,确保足够的资金投入以满足项目建设需求。

(五)项目审批风险

本项目的实施,尚需向政府有关主管部门办理备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化,存在无法取得或无法按计划取得相关许可和影响投资计划顺利实施的风险。公司会按照当地相关部门要求,积极推进项目投资建设实施工作。

敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2025-066

广东世运电路科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,现将广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1017号),本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股股票117,964,243股,发行价为每股人民币15.20元,共计募集资金179,305,65万元,坐扣承销及保荐费1,393.06万元(该部分为不含税金额,属于发行费用),持续督导费400.00万元(该部分不属于发行费用)后的募集资金为177,512.59万元,已由主承销商中信证券于2024年3月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用212.36万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为177,700.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2024〕3-8号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	177,700.23
截至期初累计发生额	项目投入	B1	49,472.84
	利息收入净额	B2	1,280.35
本期发生额	项目投入	C1	5,467.58
	利息收入净额	C2	1135.30
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	54,940.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	2,415.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	125,175.47
实际结余募集资金		F	125,249.04
差异		G=E-F	-73.57

注1:公司应结余募集资金比实际结余募集资金少73.57万元,其中,目有资金账户支付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用81.90万元;募集资金专户销户,产生的利息和理财收益8.17万元;转账产生的手续费0.16万元所致。

注2:以上数据如有尾差为四舍五入所致。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐人中信证券于2024年4月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销,所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,本公司有4个募集资金专户、4个募集资金理财专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号/证券账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司鹤山共和科技支行	44411501040010258	616.06	
中国银行股份有限公司江门鹤山共和科技支行	740678234630	116,991,365.60	
中国工商银行股份有限公司鹤山共和科技支行	2012006228200081444	2,759,863.03	
中信银行股份有限公司江门分行	8110901012101686782	132,738,599.90	
中国银河证券股份有限公司江门发展大道证券营业部	3333000303368	100,000,000.00	
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部	1929000061808	700,000,000.00	
广发证券股份有限公司江门恩平证券营业部	1929000061810	0	
中信证券股份有限公司江门码超大道证券营业部	3500000002813	200,000,000.00	
合计		1,252,490,444.59	

三、本报告期募集资金实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司向特定对象发行A股股票募集资金在本报告期的使用情况,参见"向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表"(见附件)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。置换金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,于2024年4月24日出具了《关于广东世运电路科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2024〕3-221号),并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。

公司于2024年7月24日置换4,722.96万元,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

公司于2024年4月1日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。

报告期内,公司使用募集资金进行现金管理明细如下:

金额单位:人民币万元

受托人	产品名称	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	截至报告期末未到期金额	本金回收情况
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4586期	券商理财产品	10,000,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4587期	券商理财产品	20,000,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4588期	券商理财产品	20,000,000.00	2024/5/13	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBR1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBN1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBO1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBM1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBO1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBP1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIYBS1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/10/28	2025/2/18	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4804期-数字看涨(银河中国多策略指数)	券商理财产品	50,000,000.00	2024/10/29	2025/2/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4805期-保守看涨(银河商品动量指数)	券商理财产品	50,000,000.00	2024/10/29	2025/3/27	保本浮动收益	0.00	全部收回
银河证券	"银河金鼎"收益凭证4843期-保守看涨(银河商品动量指数)	券商理财产品	50,000,000.00	2024/11/15	2025/3/17	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIUCA1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/11/22	2025/2/20	保本浮动收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIUCB1)	券商理财产品	100,000,000.00	2024/11/22	2025/2/20	保本浮动收益	0.00	全部收回
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20111期	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/1	2025/5/6	保本浮动收益	0.00	全部收回
中国银行	人民币结构性存款【CSDVY202503242】	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/24	2025/5/12	保本浮动收益	0.00	全部收回
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21058期	券商理财产品	200,000,000.00	2025/2/22	2025/5/23	保本浮动收益	0.00	全部收回
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08894期	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/22	2025/5/23	保本固定收益	0.00	全部收回
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIUFE1)	券商理财产品	100,000,000.00	2025/2/26	2025/8/27	保本浮动收益	100,000,000.00	/
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIUFF1)	券商理财产品	200,000,000.00	2025/2/26	2025/8/27	保本浮动收益	200,000,000.00	/
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"1号(GISYD7)	券商理财产品	300,000,000.00	2025/2/26	2025/8/27	保本浮动收益	300,000,000.00	/
中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A04856期	券商理财产品	100,000,000.00	2025/5/22	2025/8/20	保本浮动收益	100,000,000.00	/
银河证券	"银河金鼎"收益凭证5049期-保守看涨(银河中国多策略指数)	券商理财产品	100,000,000.00	2025/5/23	2026/2/26	保本浮动收益	100,000,000.00	/
广发证券	广发证券收益凭证"收益宝"4号(GIUGZ1)	券商理财产品	100,000,000.00	2025/5/30	2025/11/26	保本浮动收益	100,000,000.00	/

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将募投项目节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按要求对募集资金使用情况进行了披露,本报告期内公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件

向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位:广东世运电路科技股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额				177,700.23	本年度投入募集资金总额					5,467.58
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					54,940.41
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
鹤山世茂电子科技有限公司年产300万平方米线路板新建项目(二期)	否	109,700.23	109,700.23	109,700.23	3,896.96	8,184.88	-101,515.35	7.46	2025年12月	不适用	不适用	否
广东世运电路科技股份有限公司多层板技术升级项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	1,580.62	8,755.54	-21,244.46	29.19	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	177,700.23	177,700.23	177,700.23	5,467.58	54,940.41	-122,759.81	30.92	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2024年4月24日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金4,722.96万元。公司已于2024年7月24日完成置换,合计用募集资金置换募投项目先期投入资金共计人民币4,722.96万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况		公司于2025年4月15日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过110,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日12个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。 截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币110,000万元。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2025-068

广东世运电路科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年9月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届